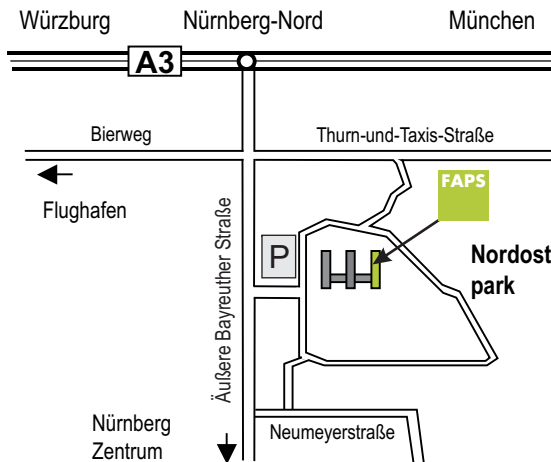


Bitte senden Sie uns die ausgefüllte  
Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail

- im Umschlag an die vorgedruckte Adresse
- per E-Mail an [service@faps-tt.de](mailto:service@faps-tt.de)
- per Fax an 09131 / 302528



**Veranstaltungsort:**

Das Seminar und die Laborpräsentation finden in der  
Forschungsfabrik Nürnberg, Nordostpark 89, mit dem  
Labor zur Elektronikproduktion statt.

**Anmeldung:**

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit  
Vorlage der Anmeldebestätigung. Verwenden Sie bitte  
zur Anmeldung die vorgedruckte Antwortkarte. Die  
Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Registrierung erfolgt  
nach Eingangsdatum.

**Teilnahmegebühr und Leistungen:**

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 340,- € zzgl. MwSt. ist  
nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene  
Konto zu überweisen und schließt Tagungsunterlagen,  
Pausengetränke und Mittagessen mit ein.

**Rücktritt:**

Bei Rücktritt bis zu 10 Tagen vor dem Seminar erheben  
wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- €. Nach dieser  
Frist ist die Teilnahmegebühr gemäß Rechnung zu  
zahlen. Die Seminarunterlagen werden dann zugesandt.

**Weitere Informationen:**

FAPS-TT GmbH  
Prof. Dr.-Ing. J. Franke  
Telefon: 09131 / 85 27971  
Telefax: 09131 / 302528  
E-Mail: [service@faps-tt.de](mailto:service@faps-tt.de)

Fachseminar zur  
Elektronikproduktion

**Aktuelle Entwicklungen zur  
Aufbau- und Verbindungstechnik**

- Materialien, Komponenten und  
Fertigungsprozesse
- Neue Herausforderungen in der  
Elektronikproduktion
- Referenten aus Industrie und  
Wissenschaft

**1. Dezember 2010**

**Nürnberg**

Forschungsfabrik  
Nordostpark 89

Fachliche Leitung:

Prof. Dr.-Ing. J. Franke,  
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung  
und Produktionssystematik

**Ich melde mich an für das Fachseminar  
Elektronikproduktion, 1. Dezember 2010**

Titel, Vorname, Name

Firma

Abteilung

Tätigkeitsbereich / Themenfeld

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum, Unterschrift

**Antwort**

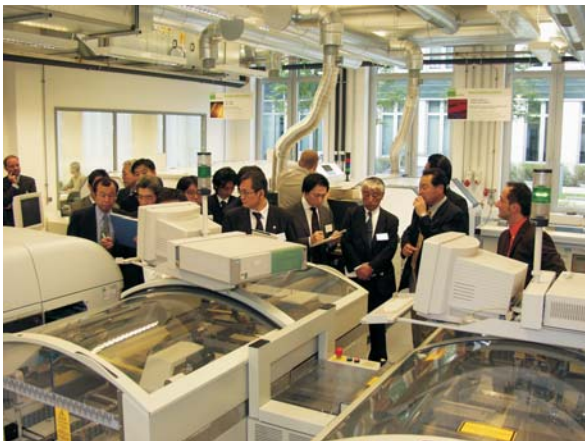
FAPS-TT GmbH  
- Elektronikproduktion -

Fürther Straße 246  
90429 Nürnberg

## Entwicklungen zur Aufbau- und Verbindungstechnik

Die weitere Miniaturisierung elektronischer Bauelemente, die schnelle Einführung neuartiger Schaltungsträger und alternativer Verbindungstechnologien sowie die Produktion mit bleifreien Loten führen zu neuen Herausforderungen in der Elektronikproduktion. Für die Aufbau- und Verbindungstechnik gilt es, Anlagen und Prozesse anzupassen oder neu zu entwickeln. Diese weiterführende Optimierung erfordert innovative Strategien und neuartige Konzepte.

Im Rahmen dieses Seminars stellen erfahrene Experten aus Industrie und Forschung neue Ansätze zur Technologieoptimierung und ihre Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung vor. Entlang der Prozesskette Lotpastenauftrag, Bestücken und Löten werden aktuelle Schwerpunkte gesetzt sowie neue Herausforderungen in der Elektronikproduktion aufgezeigt.



Ziel der Veranstaltung ist es, einen aktuellen Informationstransfer mit Vorträgen, ergänzenden Fachdiskussionen sowie den Vorführungen in den Labors zu bieten. Das Forum in der Forschungsfabrik Nürnberg im Nordostpark mit dem Labor zur Elektronikproduktion bietet dazu beste Möglichkeiten.

Das Tagesprogramm bietet Gelegenheit zur Diskussion individueller Problemstellungen und spezifischer Sachfragen zur Aufbau- und Verbindungstechnik.

## Programm

- 09:00 **Ganzheitliche Optimierung und gesicherte Teilprozesse in der Baugruppenmontage**  
Prof. J. Franke, Lehrstuhlinhaber  
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- Materialien und Komponenten**
- 09:30 **Spezielle bleifreie Lotpasten für erhöhte Zuverlässigkeit**  
A. Miric, Director Product Line Automotive & Industrial Microbond Assembly Materials  
W. C. Heraeus GmbH, Materials Division, Hanau
- 10:00 **Aktuelle Trends in der Leiterplattenfertigung**  
G. Georgiev, Projektingenieur  
KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf
- 10:30 *Kaffeepause*
- 10:50 **Nächste Generation SAW Packages: Anforderung an Anlagen und Material**  
Dr. J. Portmann, Director Process Development  
EPCOS AG, A Group Company of TDK-EPC Corporation, München
- Fertigungsprozesse**
- 11:20 **Qualitätsdatenanalyse zur Darstellung von Fehlerschwerpunkten im Schablonendruck**  
M. Rösch, wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 11:50 **Präzision und Flexibilität in der Mikromontage durch ein modulares Maschinenkonzept**  
M. Thamm, Chief Marketing Officer  
HÄCKER Automation GmbH, Schwarzhausen
- 12:20 *Mittagspause*
- 13:20 **Drahtbonden mit neuen Oberflächenmaterialien**  
Dr. J. Sedlmair, Sales Coordination International  
F&K Delvotec Bondtechnik GmbH, Ottobrunn

## Programm

- 13:50 **Flexible Lötprozesse für die Umsetzung sich wandelnder Produkthanforderungen**  
R. Diehm, Leiter Forschung und Entwicklung  
SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim
- Neue Herausforderungen**
- 14:20 **Umweltsimulation zur Zuverlässigkeitsabsicherung bei KFZ-Elektronik**  
G. Vogl, Leiter Automotive Quality Labs  
Continental Automotive GmbH, Regensburg
- 14:50 *Kaffeepause*
- 15:10 **Stay cool - Kühlung von Leistungskomponenten und deren Einfluss auf die Lebensdauer**  
Dr. U. Scheuermann, Manager Product Reliability  
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg
- 15:40 **Angepasste Kontaktierungsverfahren für Flip-Chips mit kleinsten Lötstellengeometrien**  
F. Schüßler, wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 16:10 **Gedruckte Elektronik - Status und Applikationen**  
K. Ludwig, Product Manager PolyLogo  
polyIC GmbH & Co. KG, Fürth
- Systemlösungen entwickeln und erproben**
- 16:40 **Laborpräsentationen**  
Im Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion mit temperierter Versuchshalle, Reinraum und Prüflabors werden alternative Systemlösungen zum Lotpastenauftrag, Bestücken und Löten mit prozessbegleitender Qualitätssicherung vorgestellt.
- 17:40 **Abschlussdiskussion**

*Falls Sie spezifische Fragen oder Interessen haben - nennen Sie uns Ihre Anliegen gerne vorab.*